|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技術主題** | ○○○○○○○○○○潛力學程 | **學程****經費** | ○○○○○○元(委辦款及企業出資總計) |
| **申請單位** | ○○○○○○○○○○ |
| **執行期間** | 112/○○/○○-112/○○/○○  | **時數** | ○○ | **預計人數** | ○○ |
| **培訓地點** |  |
| **需求單位****(企業)** |  |
| **學程對象** | 說明適訓學員條件，例如新南向國際生、國內頂尖大學之基礎科學科系、私立前段大學之電機電子相關科系、企業新招募人才。 |
| **前瞻範疇** | □高階設計：□系統架構 □高階射頻 □記憶體 □電力電子 □前瞻製程佈局 □測試□高階製程與材料：□奈米製程 □先進設備 □元件製程整合開發□高階封裝：□先進封裝研發 □先進設備□其他  |
| **學程方向與****前瞻主題規劃** | 填寫說明:本課程之規劃，係因應何種業界實務需求或何種新興應用趨勢。說明業界對本課程內容有明確需求，或可支援某特定技術之發展。* 學程方向 (規格定義、製程選定、架構選擇、電路設計、設備升級…)
* 主題式前瞻技術規劃(如製程新材料研發、量子運算與元件、AI加速器、5G晶片)
* ○○○○○○期契合業界職務需求……
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **編號** | **課程名稱** | **課程大綱****(實作部分須說明教學設計及使用設備名稱)** | **授課專家** | **時數** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 合 計 |  |
| **專家(顧問/講師)資料** |
| **授課師資** | **學/業** | **最高學歷/經歷** | **專長** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **預期成果/效益評估**（人才媒合率/留任率須於年底達5成以上） |
| 填寫說明：請依合理性、適切性及可達成度審慎自評，請以文字說並填答質量化指標，以利委員審查。說明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **量****化****指****標** | **人力資源** | \*擇1填列培育人數： 人，預計媒合人數： 人企業人才訓練成本減少　 元、上手時間縮短\_\_\_\_其他：請說明 |
| **工作效能** | \*擇1填列人均產值上升\_\_\_\_%、工作成本下降\_\_\_\_%、作業良率提升\_\_\_\_%、專案開發時間減少\_\_\_\_%其他：請說明 |
| **質****化****指****標** | **促進實務****工作應用** | 填寫說明：請說明預期職員結訓後具備的專業技能，並評估對產業或區域發展之助益。 |

　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **專家(顧問)****簽名/日期** |  | **企業專案負責人****簽名/日期** |  |

* + **同意加入公私(產學)共育國內外高階人才計畫之國際產學交流聯盟會員。**
	+ **已屬公私(產學)共育國內外高階人才計畫之國際產學交流聯盟會員。**